

# 目次

<b>1.0 適用範囲 / はじめに</b> .....	1	<b>8.0 試験の手法</b> .....	6
1.1 用語および定義 .....	1	8.1 外観 (目視) 検査 .....	6
1.1.1 未処理の参照用テストビークル .....	1	8.2 イオン分析試験 .....	6
1.1.2 工程特性評価 .....	1	8.3 SIR 試験 .....	6
1.1.3 工程認定 .....	1	8.3.1 試験前検証 - 測定器 .....	6
1.1.4 製造者 .....	1	8.3.2 試験条件と測定頻度 .....	6
1.1.5 ユーザー .....	1	8.3.2.1 試験プロファイル .....	6
<b>2.0 関連文書</b> .....	2	8.3.3 SIR 後の外観 (目視) 検査 .....	7
2.1 IPC .....	2	8.3.4 写真撮影 .....	7
2.2 International Electrotechnical Commission (IEC) .....	2	<b>9.0 許容基準</b> .....	7
<b>3.0 試料</b> .....	2	9.1 SIR 試験 .....	7
3.1 IPC-B-52 標準試験用組立品 .....	2	9.2 イオン分析試験 .....	7
3.1.1 テストパターン .....	3	<b>10.0 報告</b> .....	7
3.1.2 部品表 (BOM) .....	3	10.1 報告に必要な要素 .....	7
3.2 構成材料 .....	4	<b>11.0 備考</b> .....	7
<b>4.0 サンプル数</b> .....	4	11.1 結露 .....	7
4.1 工程特性評価 .....	4	11.2 ドリップシールド .....	7
4.2 工程認定 .....	4	11.3 光学検査 .....	8
<b>5.0 装置および材料</b> .....	4	11.4 コネクタとハードワイヤの比較 .....	8
5.1 製造装置 .....	4	11.5 ケーブルのシールドへの収納 .....	8
5.2 イオン分析試験 .....	4	11.6 検証用ビークル .....	8
5.3 表面絶縁抵抗 (SIR) 試験 .....	5	11.7 設計ファイル .....	9
5.4 温湿度制御チャンバー .....	5	<b>12.0 参考文献</b> .....	9
5.5 検証用クーポン .....	5		
<b>6.0 テストビークルの処理</b> .....	5		
6.1 テストビークルの準備 .....	5	<b>図</b>	
6.2 製造工程 .....	5	図 3-1 IPC-B-52 標準試験組立品 - SIR 用主要基板パターン 2	2
<b>7.0 試験用試料の準備</b> .....	5	図 3-2 IPC-B-52 部品の実装位置 .....	4
7.1 はんだショート .....	5	図 5-1 コネクタチェックカード .....	5
7.2 ビークルの識別 .....	5		
7.3 試料のセグメント化 (分割) .....	5	<b>表</b>	
7.4 保管 .....	5	表 3-1 IPC-B-52 試験用組立品の部品表 .....	3
7.5 外部試験者への出荷 .....	5	表 8-1 SIR 試験パラメータ .....	6
7.6 ハードワイヤアタッチの準備 .....	6		
7.7 工程認定の準備 .....	6		